

Manufacturing



Automatic electrolytic Ni-Au plating equipment

LED 基板・フレキシブル基板 電解 Ni-Au めっき

～特徴～

当ラインでは、FPC・LED 基板を中心に生産しております。
その中でも薄物製品を得意としています。

～生産能力～

◎対応製品サイズ

電解 Ni-Au ライン : サイズ (MAX) 510×610mm 約 14,000 m²/Month

◎対応めっき仕様

- 電解 Ni めっき 0.50～15.0 μ m (硬質・軟質)
- 電解 Au めっき 0.01～0.20 μ m (硬質)
- 電解 Au めっき 0.03～0.80 μ m (軟質)
- 電解 Au めっき 0.10～0.80 μ m (ダイレクト軟質)

◆フリップチップ実装及び屈曲性を必要とする FPC に対応するダイレクト Au めっきも対応可能です。

◇ニッケル及び、金の組み合わせは自在です。硬質めっき・軟質めっきと選択することも出来ます。御社からのご要望に応じ提案・検討もさせていただきます。

【各ライン写真】

2号機 硬質・軟質 AuF

3号機 硬質・軟質・ダイレクト Au

5号機 ダイレクト Au



東電化工業 株式会社

Azuma Denka Industry Co.,Ltd. Company Profile